

CHL-45B460芯片说明书

Ver.201710



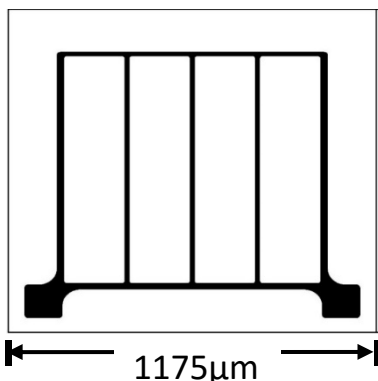
产品特点:

- 垂直结构电极，电流扩展好；
- 硅基板散热性能良好；
- 薄膜型芯片，单面出光；
- 郎伯光斑，易配光；
- 800V-ESD全测，可靠性高。

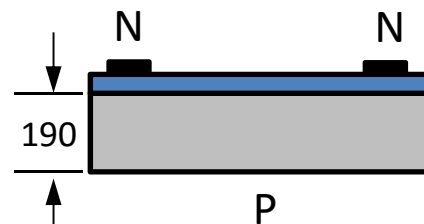
应用范围:

- 舞台灯光
- 移动照明
- 景观亮化

芯片外观 (单位 μm)



正面外观



侧面外观

芯片尺寸: $1175 \pm 10 \times 1175 \pm 10$

焊盘尺寸: 120 ± 10

芯片厚度: 190 ± 20

焊盘厚度: 3 ± 0.5

光电性能(25°C环境温度)

	条件	最小值	典型值	最大值	单位
主波长(λ_d)	$I_F=700 \text{ mA}$	450	460	470	nm
半峰宽($\Delta\lambda$)	$I_F=700 \text{ mA}$	-	20	-	nm
光功率(P_O)	$I_F=700 \text{ mA}$	750	1100		mW
光通量(lm)	$I_F=700 \text{ mA}$	-	47	-	lm
开启电压(V_{f1})	$I_F=1 \mu\text{A}$	1.9	2.0	-	V
工作电压(V_f)	$I_F=700 \text{ mA}$	3.0	3.2	3.4	V
反向漏电(I_R)	$V_F=-5 \text{ V}$	-	-	0.1	μA

最大值

正向电流	1000	mA
正向峰值电流	1200	mA
工作结温	150	°C
工作温度	-40~85	°C
储存温度	0~40	°C

分档标准@700mA

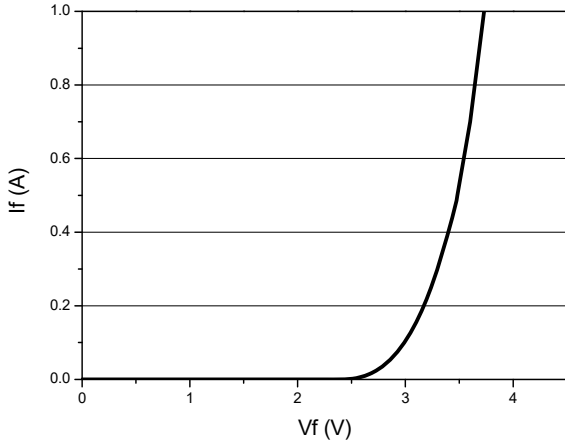
Wd(nm) \ Po(mW)	450-452.5	452.5-455	455-457.5	457.5-460	460-462.5	462.5-465	465-467.5	467.5-470
1370-1440	41							
1300-1370	51	42						
1230-1300	21 31	52	43					
1160-1230	01 11	22 32	53 23	44				
1090-1160		02	33	54	45			
1020-1090		12	03	24 34	55	46		
950-1020			13	04	25 35	56	47	
880-950				14	05	26	37	48
810-880					15	06	38	
740-810						16	07	08
							17	18

参考数据(A1)----防流明支架、硅胶灌封、热稳态测试

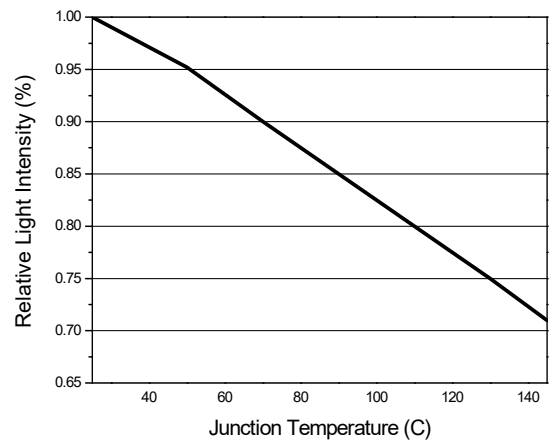
IF(mA)	VF(V)	Φ(lm)	Φe(mW)	主波长(nm)	峰值波长(nm)	半波宽(nm)
50	2.46	4.9	92.7	463.7	459.4	18.6
200	2.71	17.3	356.1	461.8	457.5	19.8
350	2.91	27.4	583.3	461.0	456.8	21.1
500	3.09	35.9	772.1	460.7	456.8	22.5
700	3.30	44.7	956.8	460.9	456.8	24.7
800	3.39	48.6	1028.0	461.1	456.8	25.8
900	3.49	51.6	1073.0	461.4	456.8	27.0
1000	3.58	53.9	1100.0	461.9	457.8	28.3

特征曲线

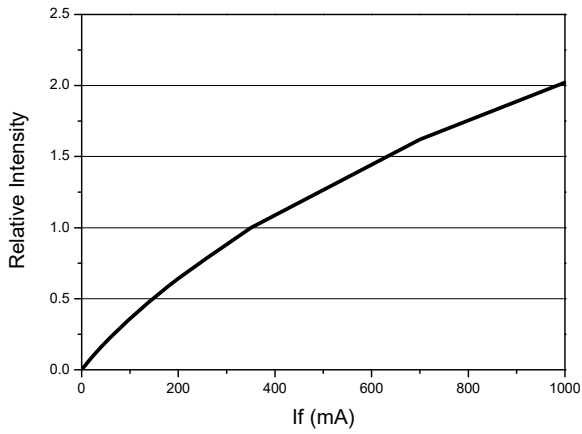
Forward Current vs. Forward Voltage



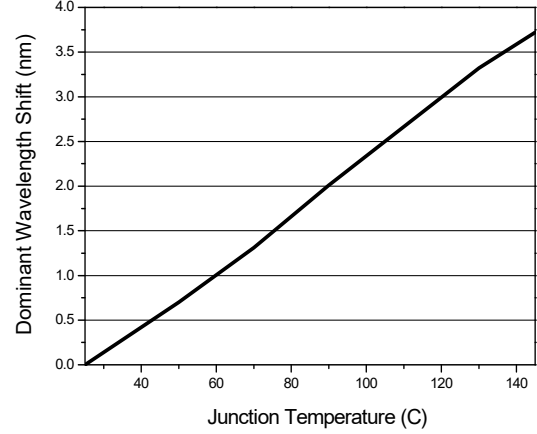
Relative Light Intensity Vs Junction Temperature



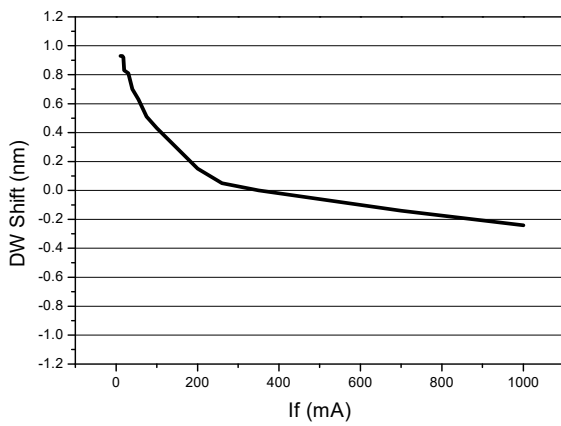
Relative Intensity vs. Forward Current



Dominant Wavelength Shift Vs Junction Temperature



Dominant Wavelength vs. Forward Current



Voltage Shift Vs Junction Temperature

